



Creating the Future with Adhesive Technologies

Linkage + Technology

LINTEC

夢をカタチにする粘着技術のリンテック

会社概要

■本 社	東京都板橋区
■証券コード	7966(東証1部)
■設 立	1934年(昭和9年)10月15日
■資本金	232億円(13年3月末)
■従業員数	4,270人(13年3月末):連結
■売上高	1,908億円(13年3月期):連結
■決算日	3月31日
■事業内容	粘着製品、粘着関連機器、特殊紙、 剥離紙・剥離フィルムなどの開発・製造・販売
■事業拠点	国内連結子会社: 4社 海外連結子会社:20社



1934年
(昭和 9年)

**ガムテープメーカー「不二紙工株式会社」
設立(東京・板橋)** ※1984年 FSK株式会社に商号変更



1960年
(昭和35年)

**ラベル用粘着紙・粘着フィルムの
製造・販売を開始**

以降、屋内外装飾、二輪・自動車関連などの
工業分野に粘着事業を拡大



1984年
(昭和59年)

**UV硬化型ダイシングテープを開発し、
半導体関連分野に本格参入**

1987年
(昭和62年)

米国のマディコ社を子会社化

1990年
(平成 2年)

**四国製紙、創研化工と合併
「リンテック株式会社」に商号変更**

特殊紙、剥離紙・剥離フィルムから粘着紙・
粘着フィルム、関連機器分野にまで業容を拡大



1991年 液晶関連分野に本格参入

(平成 3年)

1993年 琳得科(天津)実業有限公司を設立

(平成 5年)

1994年 リンテック・インドネシア社を設立

(平成 6年)

2000年 リンテック・インダストリーズ(マレーシア)社を設立

(平成12年)

2002年 琳得科(蘇州)科技有限公司を設立

(平成14年)

リンテック・スペシャリティー・フィルムズ(韓国)社を設立

2003年 リンテック・スペシャリティー・フィルムズ(台湾)社を設立

(平成15年)

2004年 リンテック・コリア社を設立

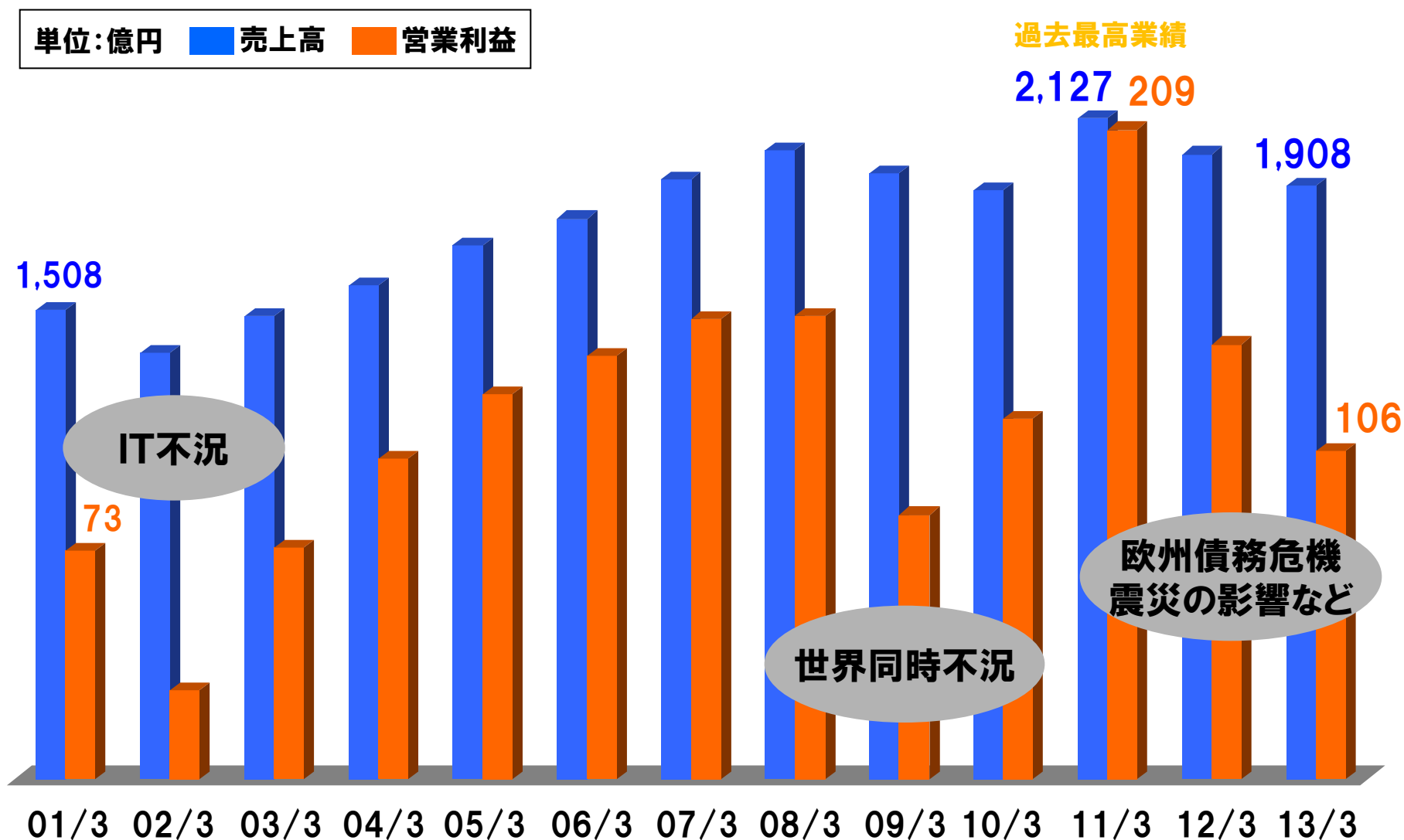
(平成16年)

2011年 リンテック・タイランド社を設立

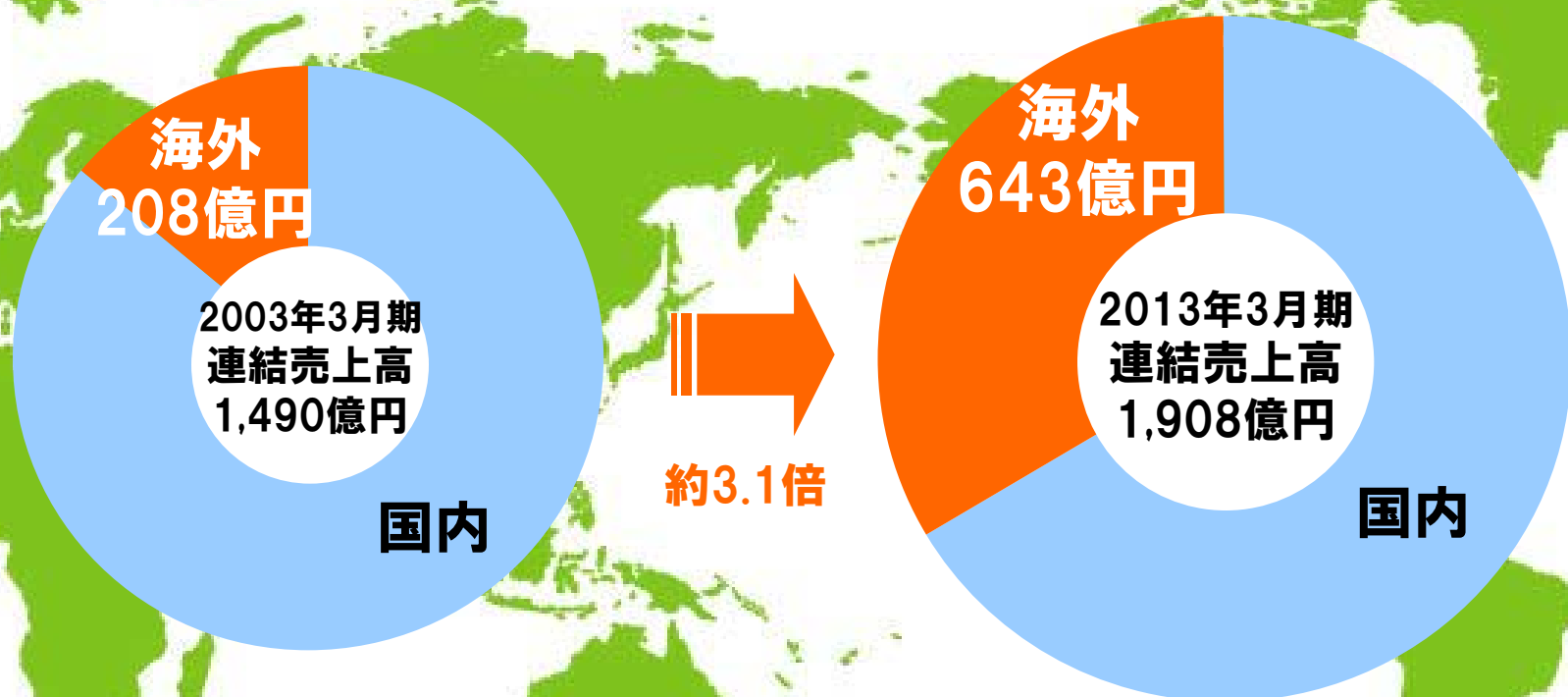
(平成23年)



業績推移／売上高、営業利益



直近10年間で435億円増加、年平均成長率12.0%
(特にアジア地域売上高の年平均成長率は15.1%)

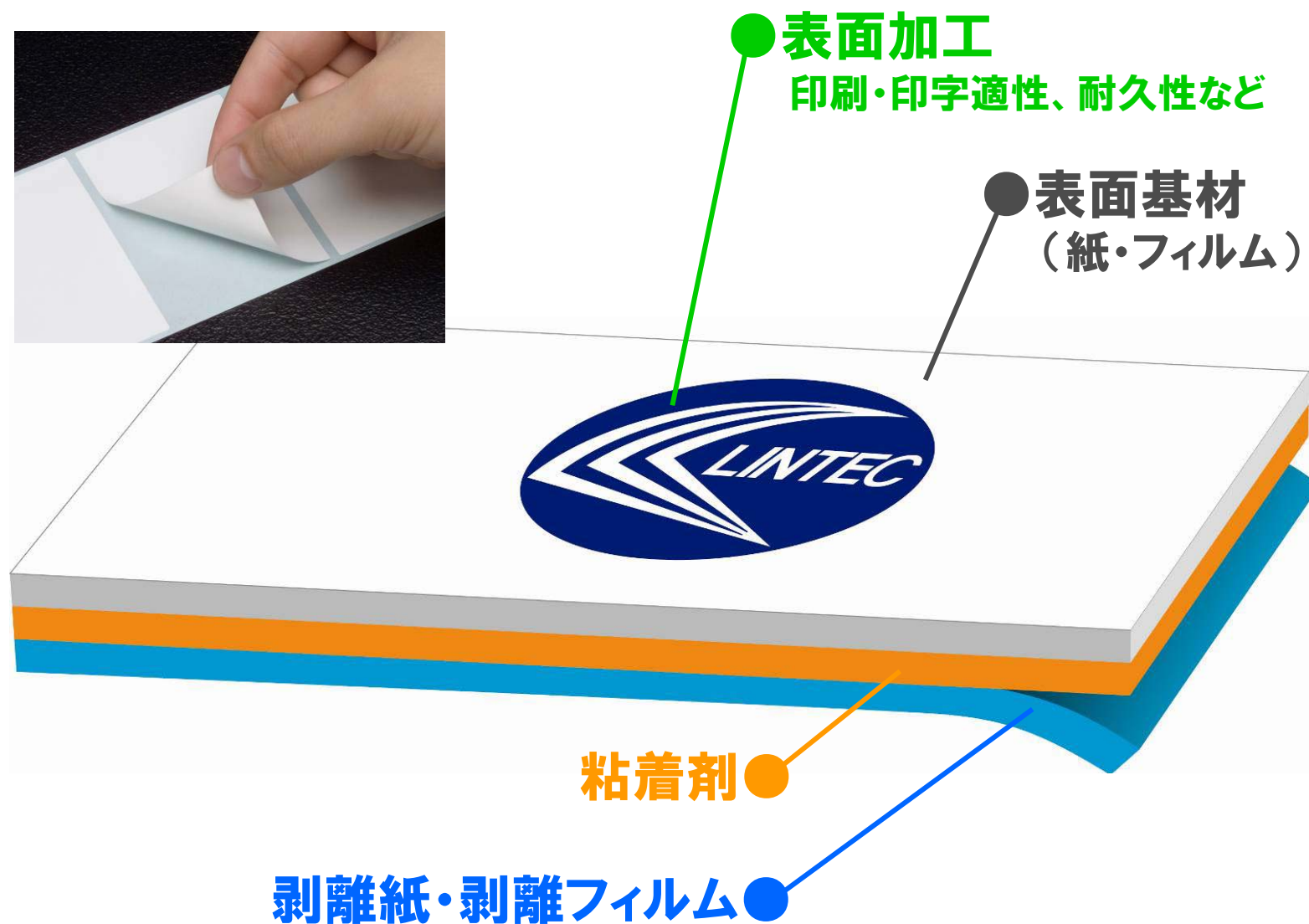
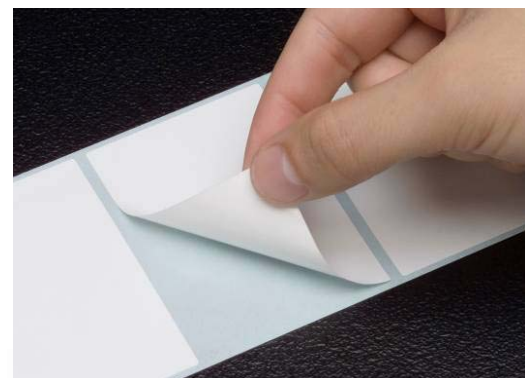


14.0%

海外売上高比率

33.7%

粘着製品の基本構成



トータルに自社技術で対応

四つの基盤技術と事業セグメント

基盤技術

1

粘着応用技術

2

表面改質技術

3

システム化技術

4

特殊紙・剥離材製造技術

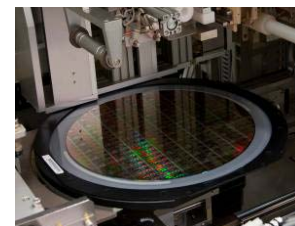
印刷材・産業工材関連

- ・印刷・情報材事業部門
- ・産業工材事業部門



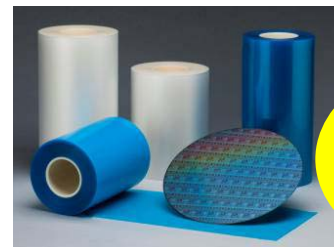
電子・光学関連

- ・アドバンスドマテリアルズ事業部門
- ・オプティカル材事業部門



洋紙・加工材関連

- ・洋紙事業部門
- ・加工材事業部門



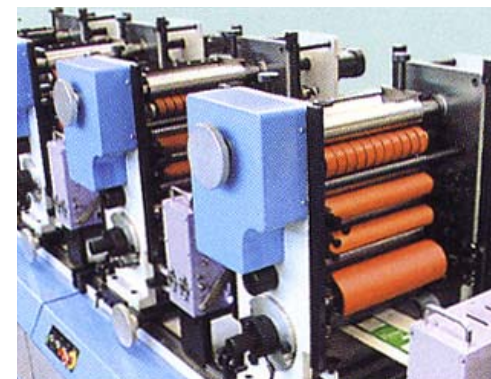
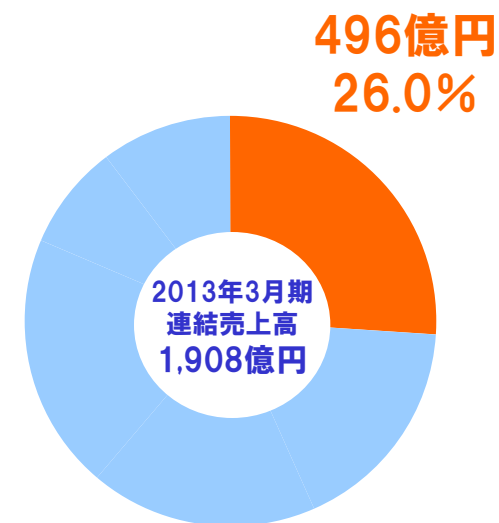
粘着素材
＋
関連機器



●ラベル用粘着紙・粘着フィルム

- 粘着剤によって、永久接着タイプ・再剥離タイプ・再貼付タイプに分けられる
- 印刷・印字適性、耐久性、耐熱性、耐水性、低温適性、曲面貼付性、寸法安定性、意匠性などに優れ、さまざまな用途や使用環境に対応

●ラベル印刷機 など



■ リンテックのラベル素材の用途／主な要求性能



● 日用品関連

- ・耐水性
- ・曲面貼付性
- ・意匠性



● 食品関連

- ・耐水性
- ・曲面貼付性
- ・低温適性



● 文具関連

- ・耐久性
- ・寸法安定性
- ・意匠性



● 流通関連

- ・印字適性
- ・捺印適性
- ・低温適性



● 医療・医薬関連

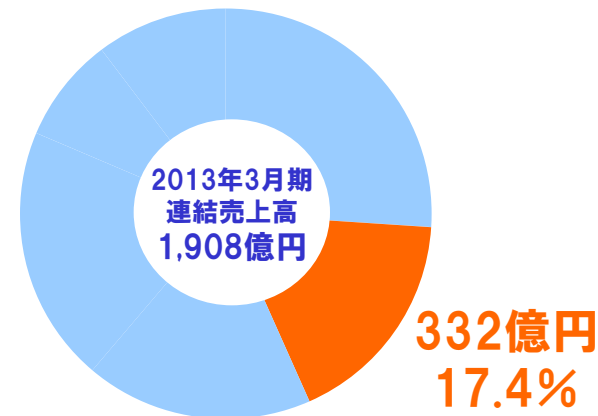
- ・印刷・印字適性
- ・耐薬品性
- ・改ざん防止機能



● 工業関連

- ・耐油・耐水性
- ・耐久性
- ・耐熱性

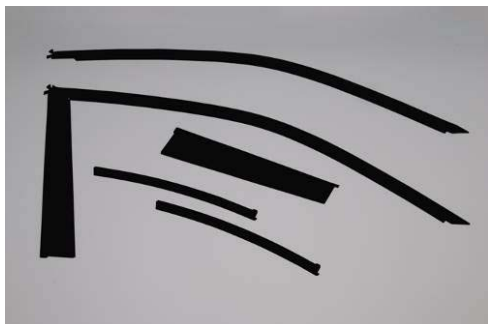
- ウィンドーフィルム
- 屋外看板・広告用フィルム
- 内装用化粧シート
- 自動車用粘着製品
- 工業用粘着テープ
- 太陽電池用バックシート
- ラベリングマシン など



●自動車用粘着製品

●ドアサッシ用塗装代替フィルム ▶▶▶

独自の材料設計によって、
空気を抜けやすくし、貼付を容易に



空気の入った状態



空気の無い状態

●アルミホイール用保護フィルム



●マーキングフィルム

●ウインドーフィルム



●太陽電池用バックシート

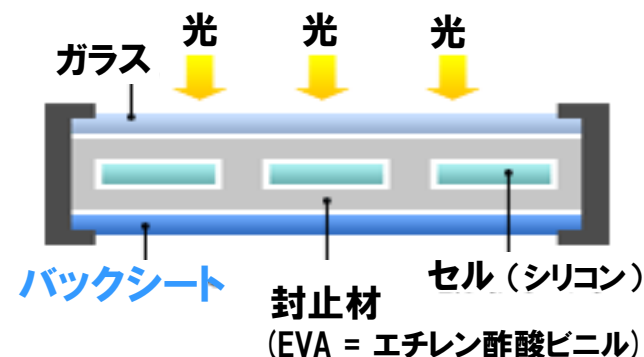
- ・太陽電池パネルの裏面を保護するシート



屋外使用への耐久性、
発電効率向上のための高反射、
電気絶縁性などが求められる

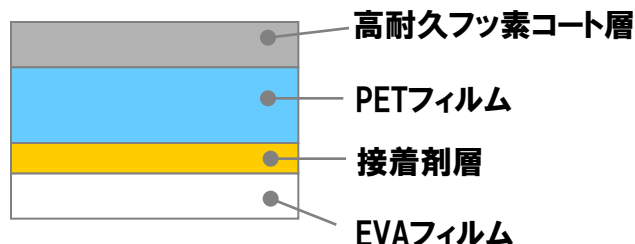


太陽電池パネルの構造

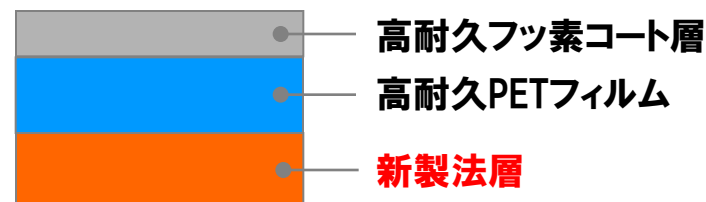


- ・新製法による次世代バックシート投入で競争力強化へ

(従来品)

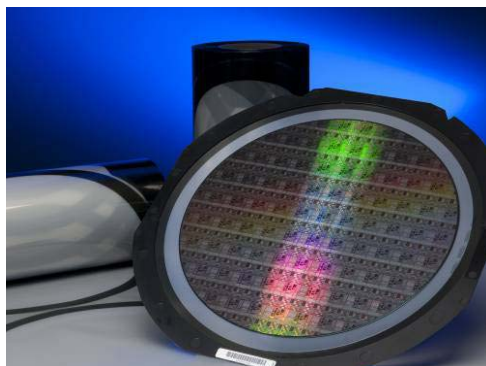
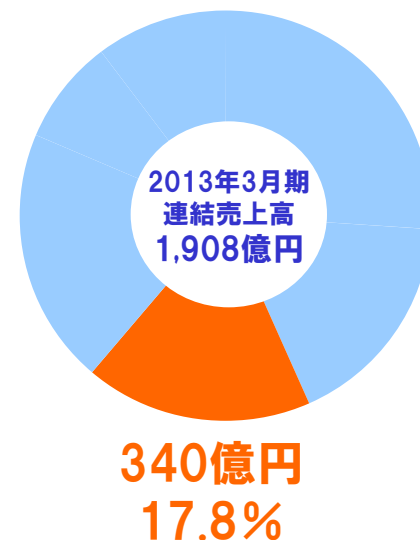


(新製法)



接着剤を用いない構成で、
耐久性を高めると同時に原価を低減

- 半導体関連テープ
- 半導体関連装置
- 積層セラミックコンデンサー製造用
コートフィルム
- タッチパネル関連製品 など



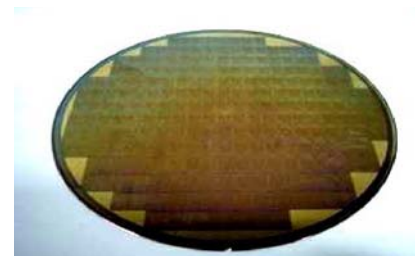
■半導体チップの製造工程

【前工程】

単結晶シリコン
インゴット



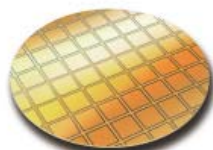
ウェハ



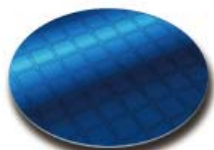
回路形成ウェハ

【後工程】

※当社テープ・装置を使用



回路形成
ウェハ



表面保護
テープ貼付



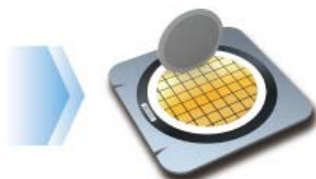
裏面研磨
(薄型化)



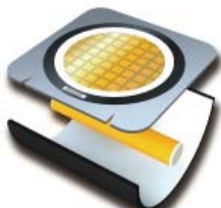
ダイシング
テープ貼付



表面保護
テープ剥離



ダイシング
(ウェハ切断)



テープへの
紫外線照射



ピックアップ



実装



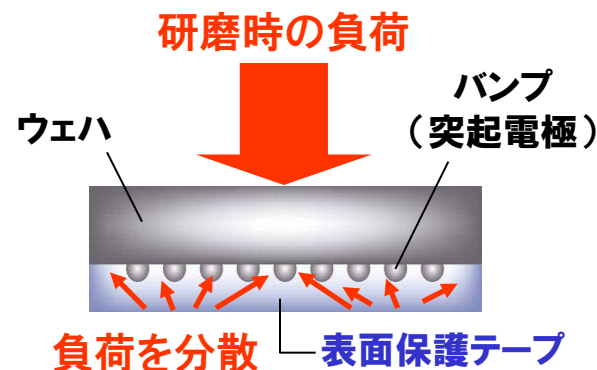
樹脂封止

● 半導体関連テープ／注力製品

● 極薄・ハイバンプウェハ対応表面保護テープ

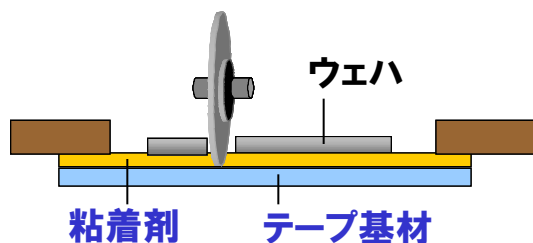
- ・特殊設計により、研磨後の薄型ウェハの反りを抑制
- ・回路面に形成されたバンプの凹凸にも、すき間なく貼ることができる、ウェハ表面の汚染を防止
- ・ウェハにかかる研磨時の負荷を分散して破損を抑制

裏面研磨工程



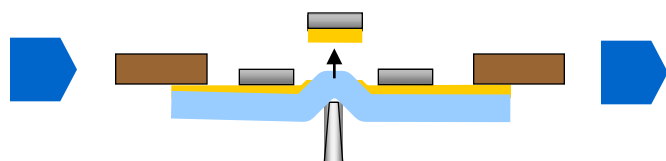
● ダイシング・ダイボンディングテープ

ダイシング(切断)工程



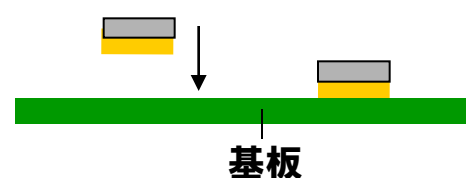
チップをしっかりと固定

ピックアップ工程



チップ裏面に粘着剤を転写

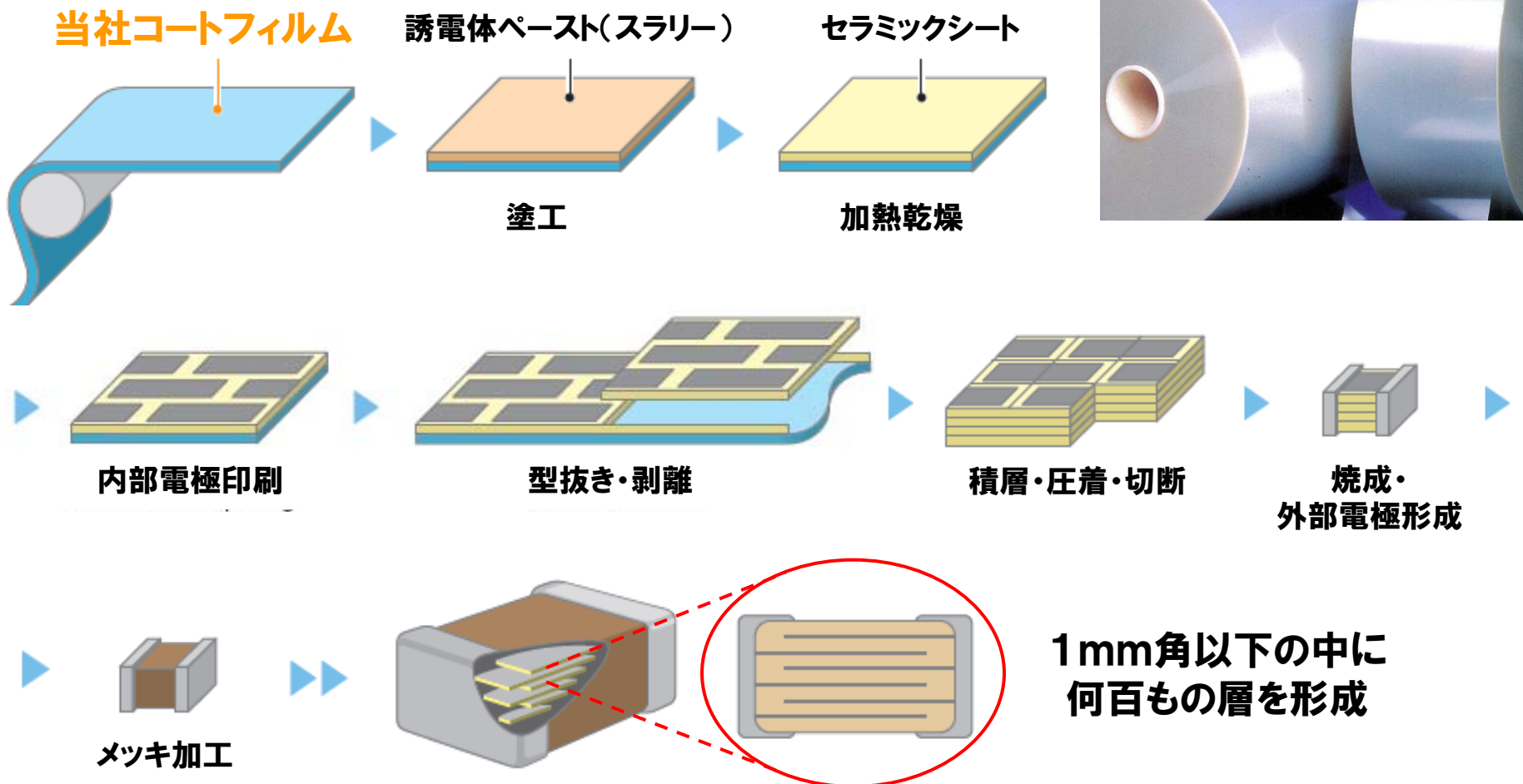
ダイボンディング(実装)工程



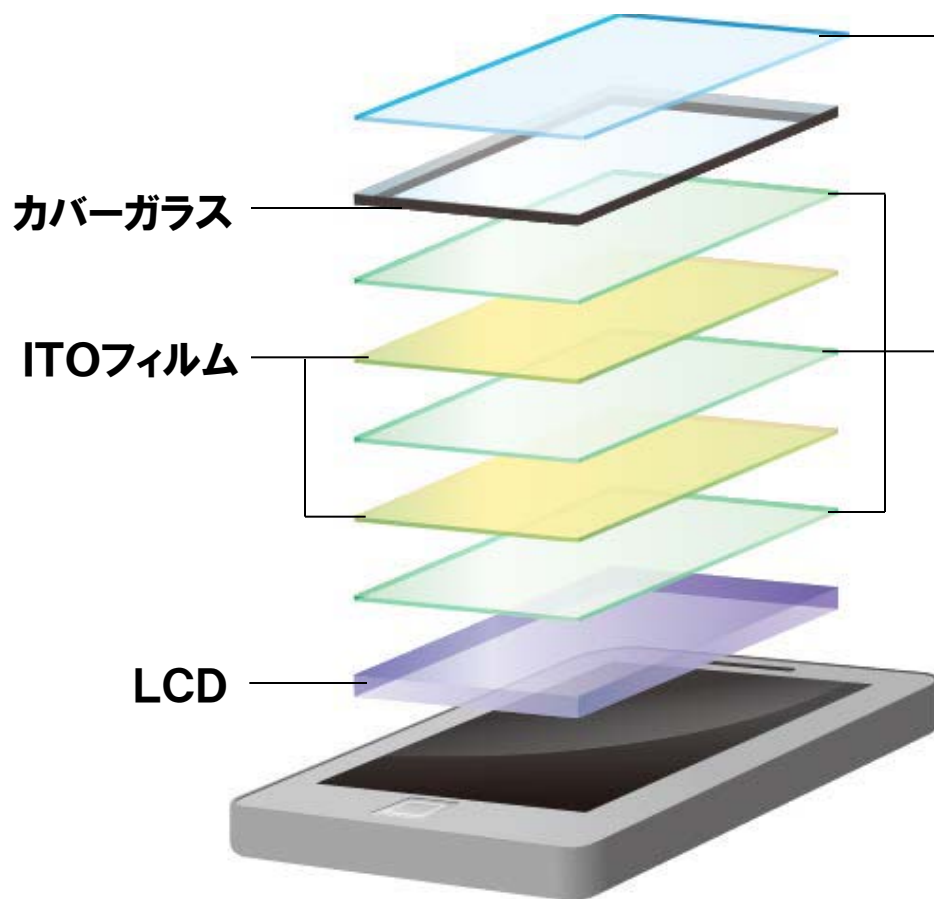
基板実装時の
接着剤塗布工程が不要に

● 積層セラミックコンデンサー製造用コートフィルム

■ 積層セラミックコンデンサーの製造工程



●タッチパネル関連製品



ガラス飛散防止 対策フィルム(ASF*)

ガラスタイプのタッチパネルの
飛散防止を目的とした粘着剤付きハードコートフィルム

*ASF: Anti-shatter Film

ASFの構成

ハードコート層
ポリエステルフィルム
粘着剤
カバ－ガラス/タッチパネル

光学粘着シート(OCA*)

*OCA: Optically Clear Adhesive

OCAの構成

軽剥離フィルム
粘着剤
重剥離フィルム

ITO用 ハードコートフィルム

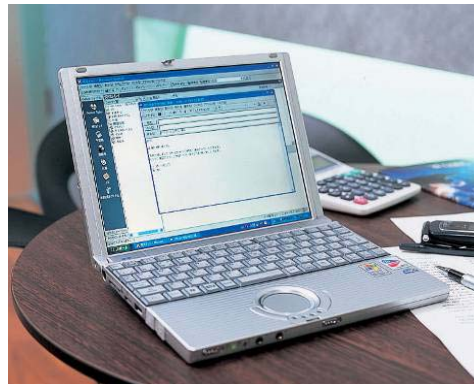
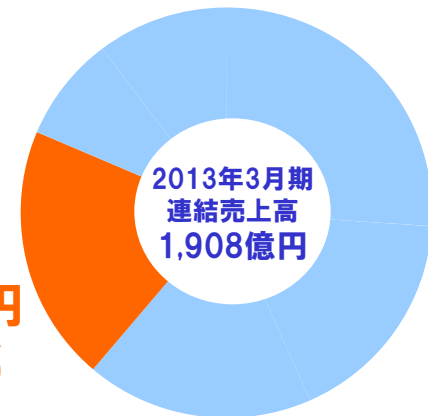
ITOフィルムのベース材料に適したハードコートフィルム

ITOフィルムの構成

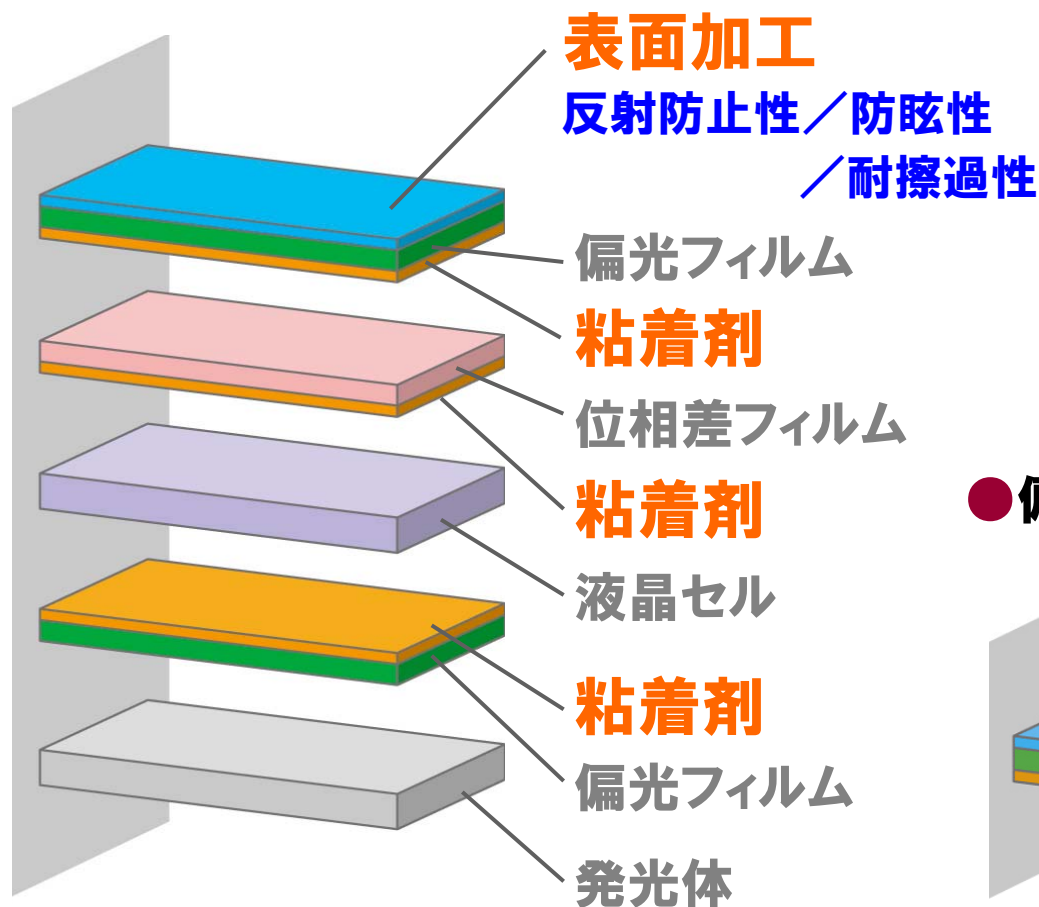
ITO(酸化インジウムスズ)
ハードコート層
ポリエステルフィルム
ハードコート層

- 液晶用偏光・位相差フィルム / 粘着加工
- 液晶用偏光フィルム / 表面加工
- 偏光フィルム用保護フィルム など

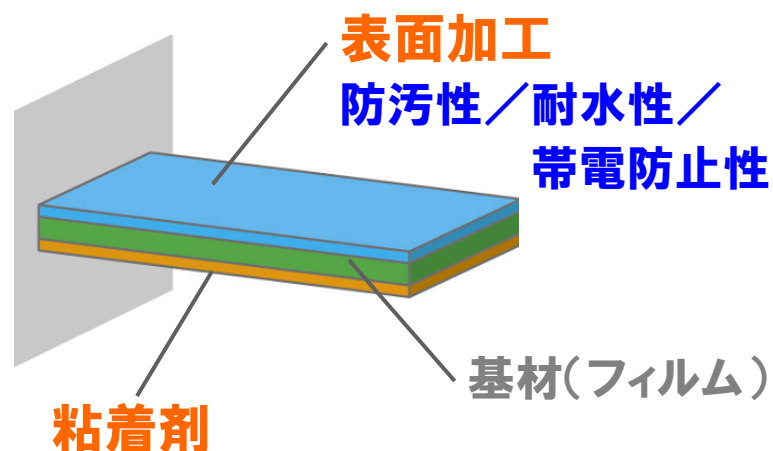
384億円
20.1%



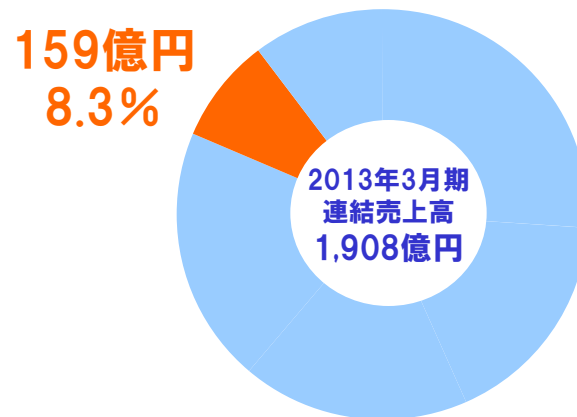
■ 液晶ディスプレイの構成



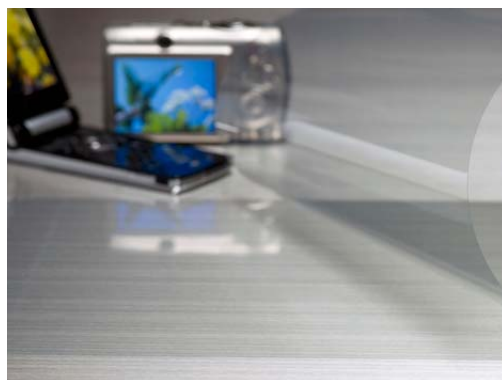
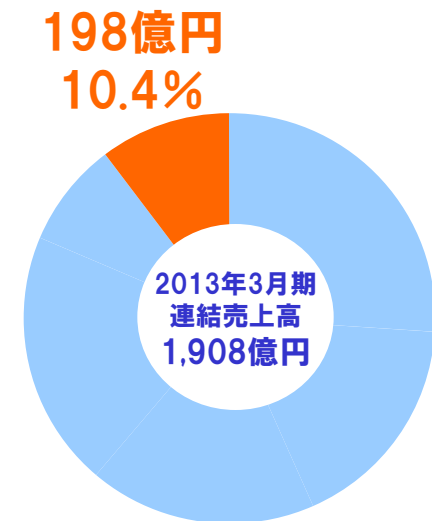
● 偏光フィルム用保護フィルム



- カラー封筒用紙
- 色画用紙
- 無塵紙
- 高級印刷用紙
- 高級紙製品用紙 など



- 粘着ラベル用剥離紙・剥離フィルム
- 光学製品用剥離フィルム
- FPC*カバーレイ用剥離紙
- 合成皮革用工程紙 (剥離紙)
- 炭素繊維複合材料用工程紙 (剥離紙) など

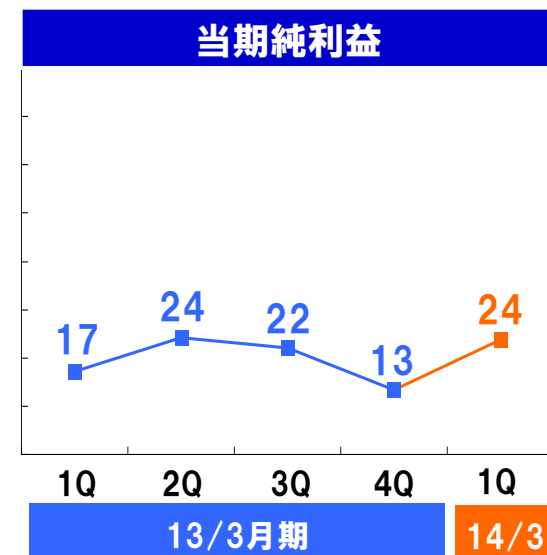
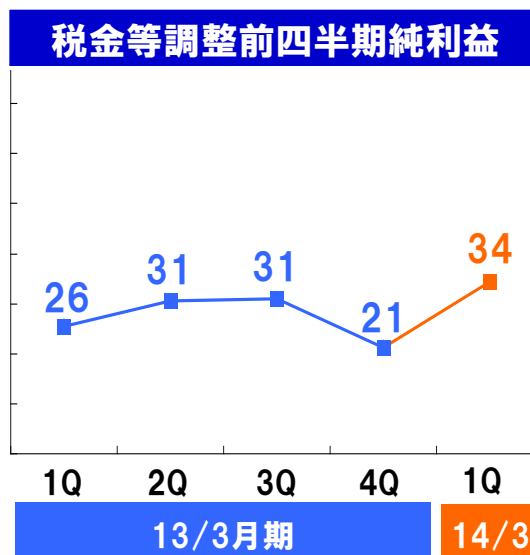
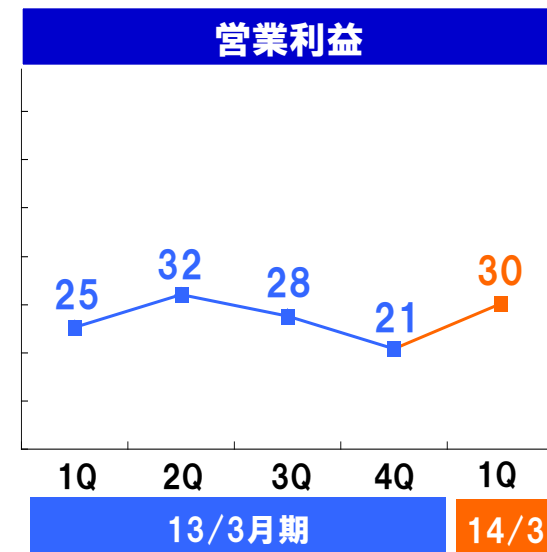
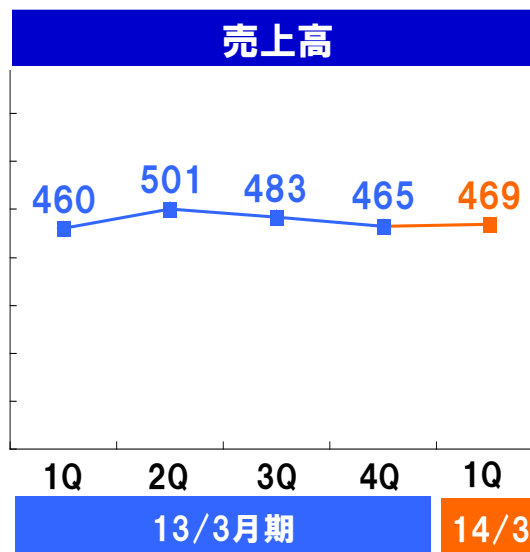


*FPC = フレキシブルプリント基板

2014年3月期第1四半期 連結業績の概要

(単位:億円)

	14/3月期 1Q実績	13/3月期 1Q実績	増減 (増減率)
売上高	469	460	9 (2.0%)
営業利益	30	25	5 (19.3%)
税金等 調整前 四半期 純利益	34	26	8 (35.1%)
当期 純利益	24	17	7 (38.9%)

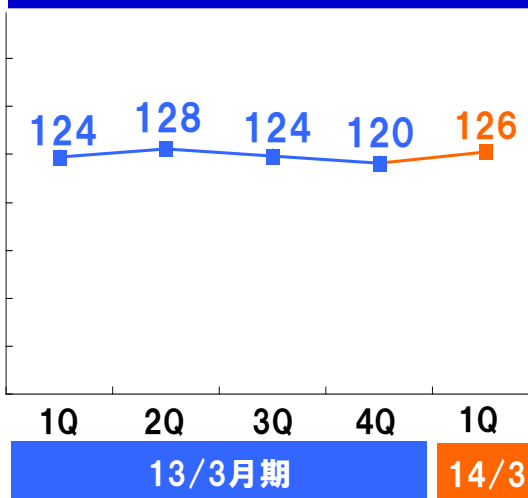


セグメント別売上高/営業利益 印刷材・産業工材関連

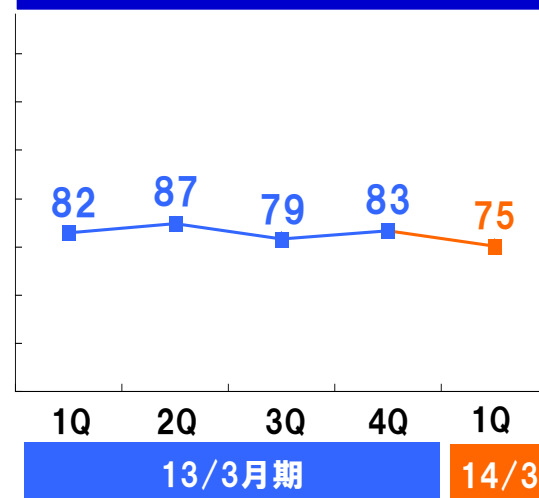
(単位: 億円)

	14/3月期 1Q実績	13/3月期 1Q実績	増減 (増減率)
印刷・情報材 事業部門	126	124	2 (1.9%)
産業工材 事業部門	75	82	▲7 (▲8.4%)
セグメント 売上高	201	206	▲5 (▲2.2%)
セグメント 営業利益	5	7	▲2 (▲38.6%)

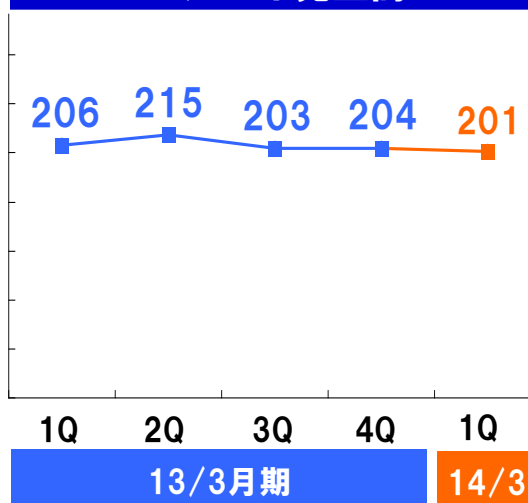
印刷・情報材事業部門 売上高



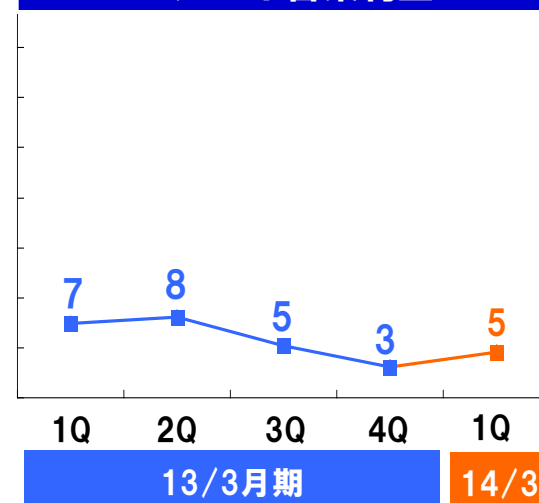
産業工材事業部門 売上高



セグメント売上高



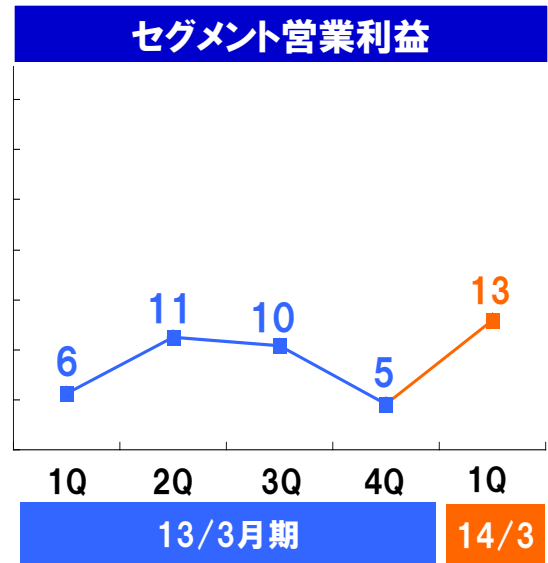
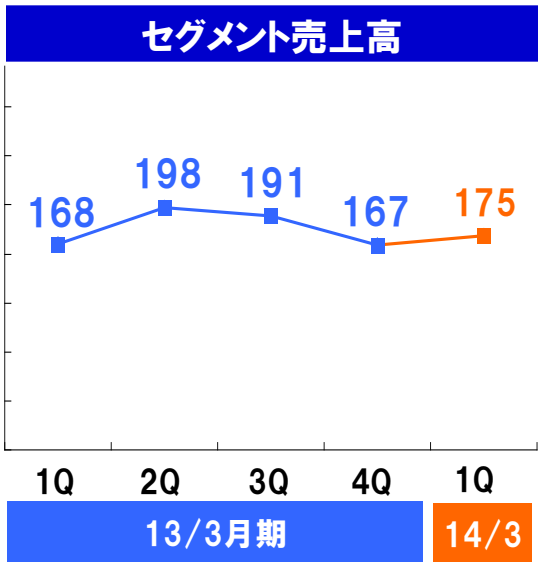
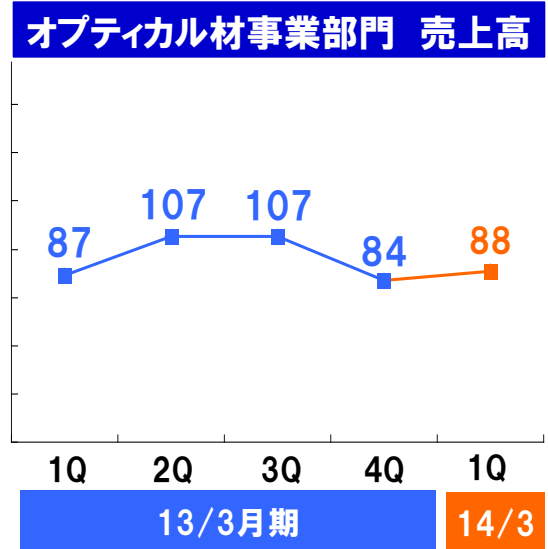
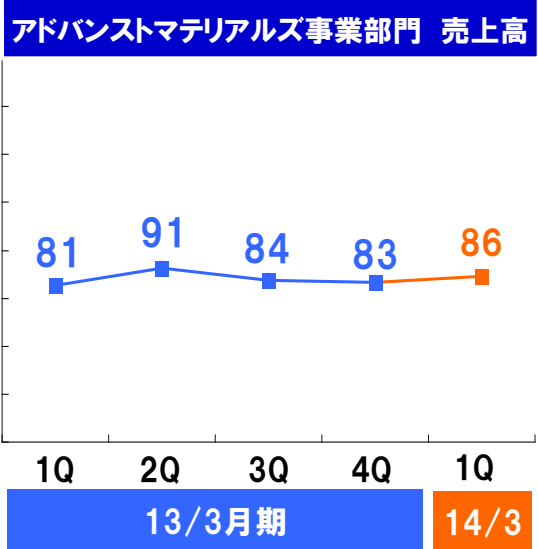
セグメント営業利益



セグメント別売上高/営業利益 電子・光学関連

(単位: 億円)

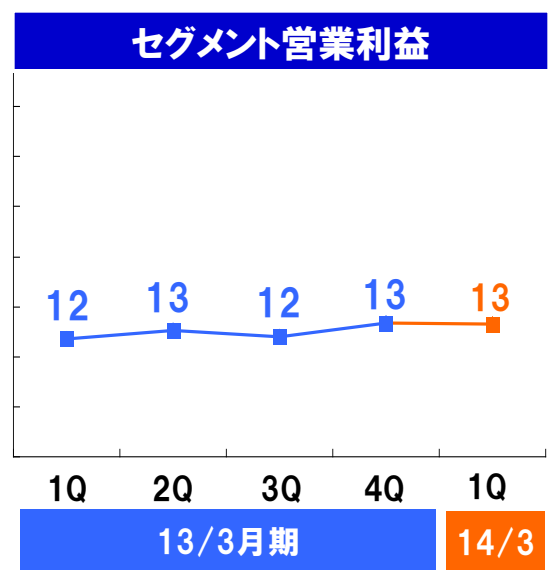
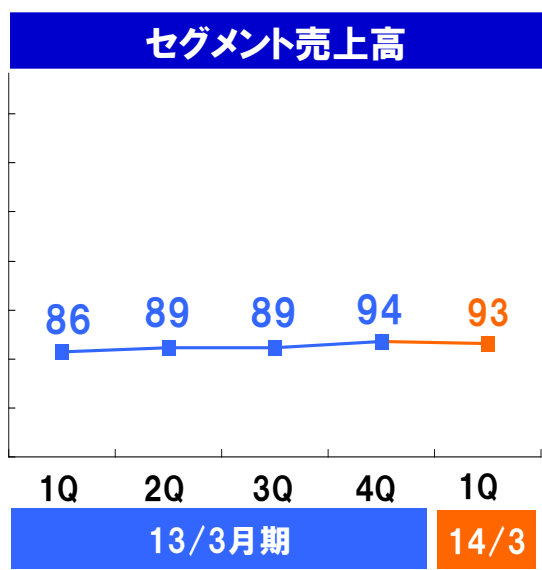
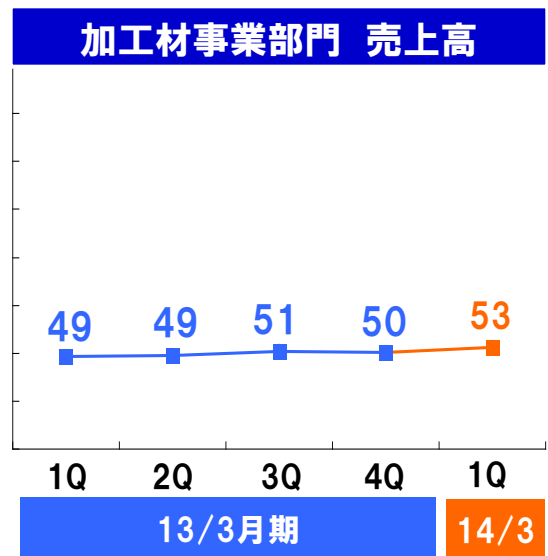
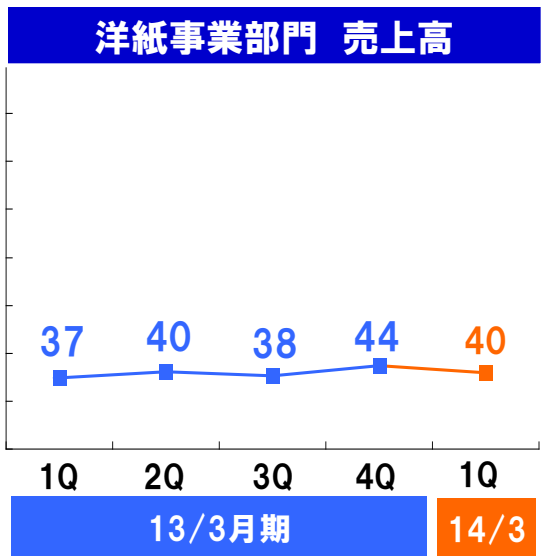
	14/3月期 1Q実績	13/3月期 1Q実績	増減 (増減率)
アドバンス マテリアルズ 事業部門	86	81	5 (5.9%)
オプティカル材 事業部門	88	87	1 (2.2%)
セグメント 売上高	175	168	7 (4.0%)
セグメント 営業利益	13	6	7 (128.6%)



セグメント別売上高/営業利益 洋紙・加工材関連

(単位:億円)

	14/3月期 1Q実績	13/3月期 1Q実績	増減 (増減率)
洋紙 事業部門	40	37	3 (7.0%)
加工材 事業部門	53	49	4 (9.6%)
セグメント 売上高	93	86	7 (8.4%)
セグメント 営業利益	13	12	1 (11.9%)



2014年3月期通期 連結業績の見通し

(単位: 億円)

14/3月期
通期予想

14/3月期
1Q実績

13/3月期
通期実績

売上高

2,100

469

1,908

営業利益

150

30

106

税金等
調整前
当期純利益

150

34

108

当期
純利益

105

24

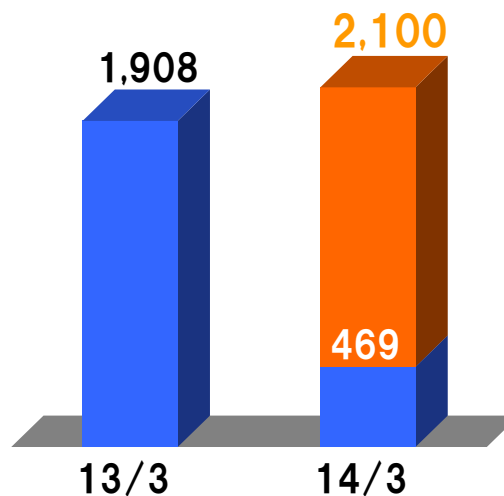
77

単位: 億円

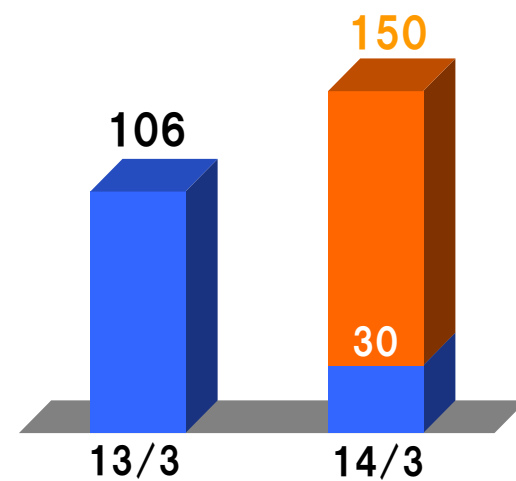
実績

予想

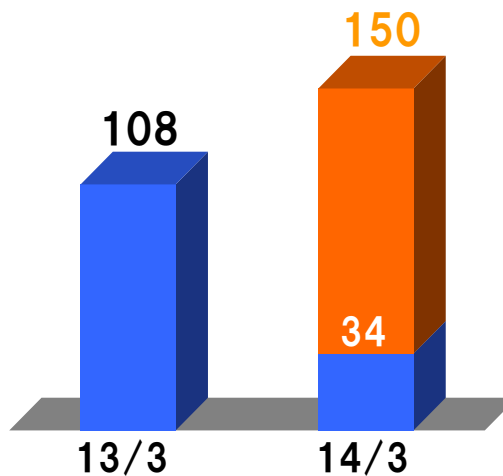
売上高



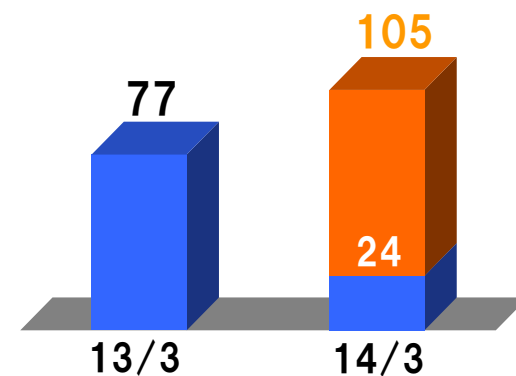
営業利益



税金等調整前当期純利益



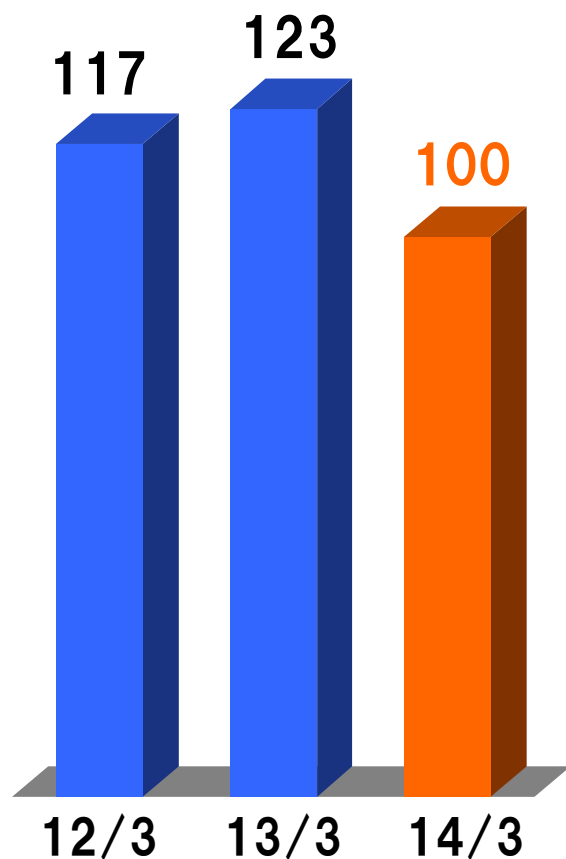
当期純利益



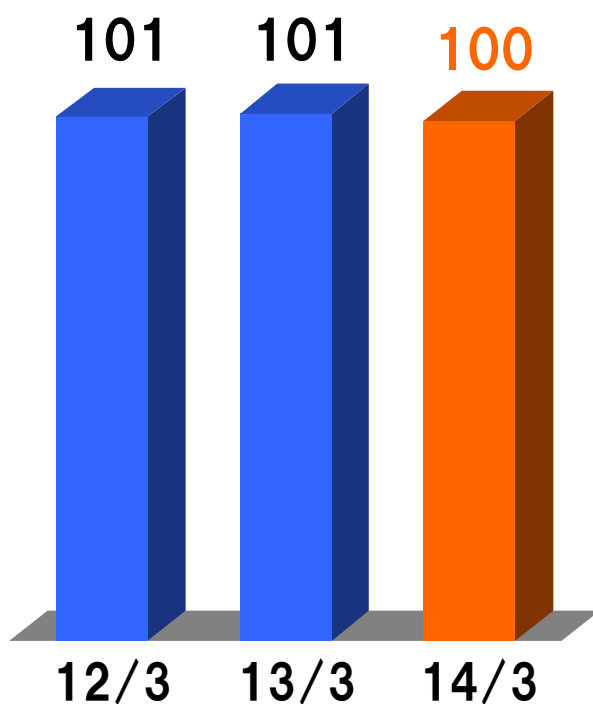
設備投資額・減価償却費・研究開発費

単位:億円 ■実績 ■見通し

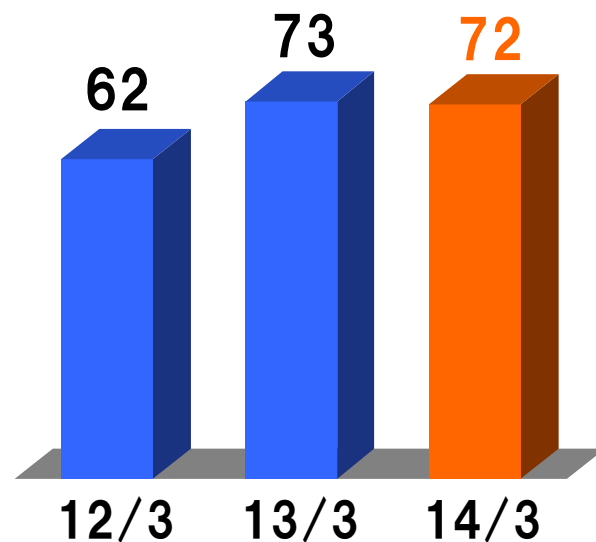
設備投資額



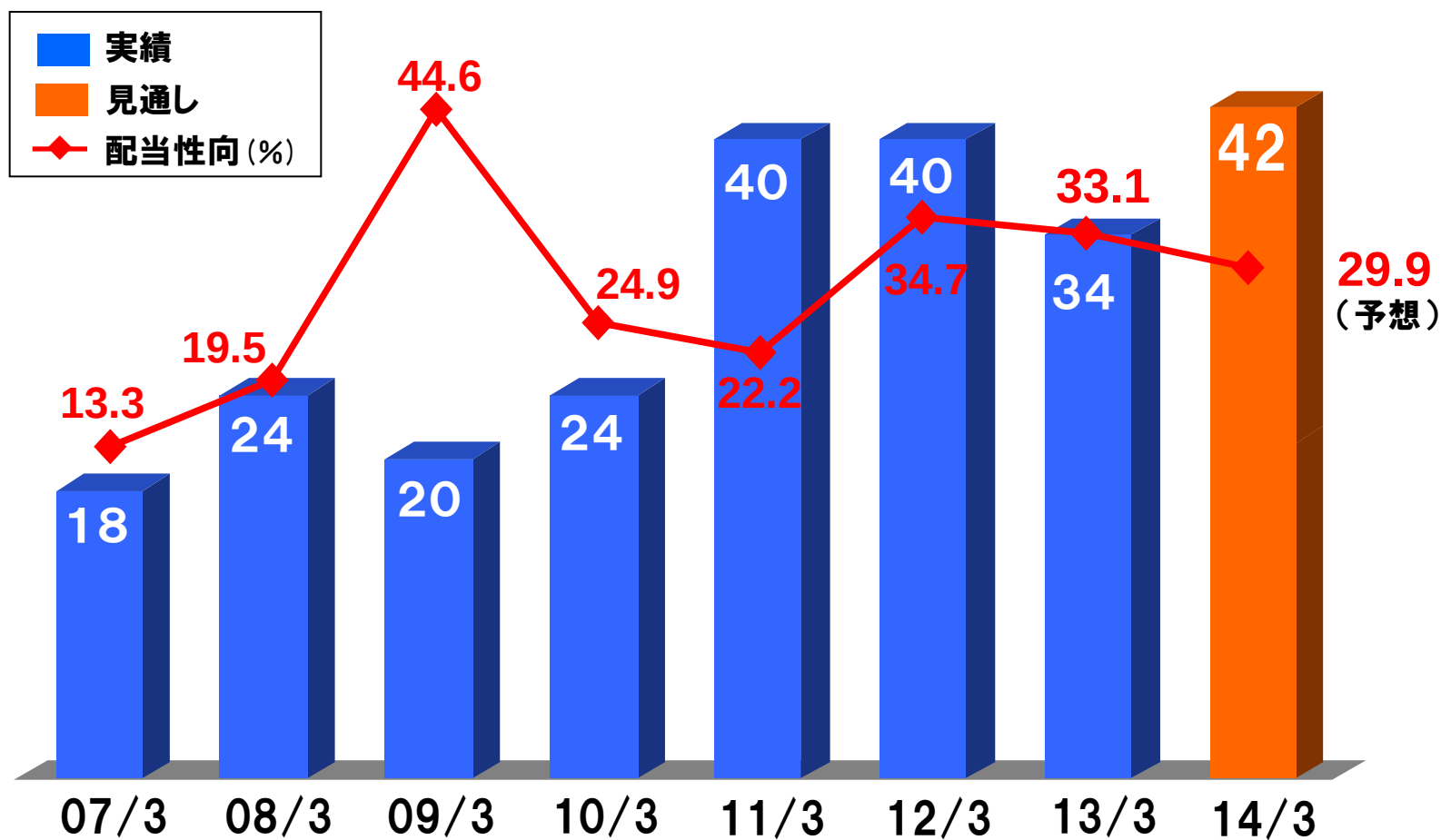
減価償却費



研究開発費



● 1株当たり配当金推移 (円)



本資料および当社製品などに関するお問い合わせ先

リンテック株式会社 広報・IR室

〒173-0001 東京都板橋区本町23-23

TEL.03-5248-7741

本資料に掲載されている業績見通しに関する内容につきましては、本資料の作成日現在において想定できる経済情勢、市場動向および計画などに基づき作成したものであり、その内容の正確性を保証したり、将来の計画数値、施策の実現を確約したりするものではありません。したがって、実際の業績は、今後のさまざまな要因によって異なる可能性があります。